



Title of Change:	Amkor Philippines Qualification of die attach epoxy CRM1191A as replacement for DA 8501.	
Proposed First Ship date:	24 March 2020	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Kazuyuki Mitsuya@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Affected products will be identified with date code	
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Amkor Phil 1
Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
Die Attach	KCC DA 8501 NON-COND	Sumitomo CRM-1191A NON-COND
There is no product marking change as a result of this change.		

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME LC88FC3K0AUTJ-2H
 RMS 62070,60818
 PACKAGE TQFP100L

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500cyc
THB	JESD22-A101	Temp = 85°C, RH=85%, bias = 100% of rated V or 100V max A101	1008 hrs
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15psig	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL3@ 260°C	

Estimated date for qualification completion: 1 November 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
LC88FC2F0BUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC3J0AUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC3K0AUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC2D0BUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC2H0BUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC3H0AUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN22818X

発行日 : 24 September 2019

変更件名:	DA 8501 の代替品として、Amkor Philippines におけるダイ接着剤エポキシ CRM1191A の認定	
初回出荷予定日:	24 March 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Kazuyuki Mitsuya@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点: Amkor Phil 1
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
ダイ接着剤	KCC DA 8501 NON-COND	Sumitomo CRM-1191A NON-COND
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



認定計画:

デバイス名: LC88FC3K0AUTJ-2H

RMS: 62070, 60818

パッケージ: TQFP100L

テスト	仕様	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500cyc
THB	JESD22-A101	Temp = 85°C, RH=85%, bias = 100% of rated V or 100V max A101	1008 hrs
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15psig	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL3@ 260°C	

認定完了予定日 : 1 November 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
LC88FC2F0BUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC3J0AUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC3K0AUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC2D0BUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC2H0BUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H
LC88FC3H0AUTJ-2H	LC88FC3K0AUTJ-2H